

NO	発表日	発表時間	発表時間	会場	セッションNO	産学	セッション名	演題名	氏名	所属
基調講演	9月7日	9:30	10:30	U	7U1-1	森裕幸 (日本アイ・ピー・エム)	基調講演	エレクトロニクス実装の低炭化がもたらす持続的社會への貢献と挑戦	島村行人	千住金属工業株式会社
	9月7日	10:30	11:30	U	7U1-2	森裕幸 (日本アイ・ピー・エム)	基調講演	デザイン・技術・経営の三位一体型事業開発	丸尾弘志	日経IP総合研究所
表彰式	9月7日	11:30	11:50	U	7U2-1		表彰式	ベストペーパー賞 5名、研究奨励賞 4名		
0028	9月7日	12:45	13:05	A	7A1-1	乃万 裕一 (昭和電工マテリアルズ)	2.50/30 ICパッケージ-1	ハイブリッド接合に向けた化学接着剤の開発	○岩田 知也、中山 航平、香澤 淳也、金子 義太、大西 浩典、北川 直人、井上 史大	横浜国立大学
0081	9月7日	13:05	13:25	A	7A1-2	乃万 裕一 (昭和電工マテリアルズ)	2.50/30 ICパッケージ-1	直接接合に向けた低温度接着剤の開発	○大西 浩典、岩田 知也、北川 直人、金子 義太、井上 史大	横浜国立大学
0068	9月7日	13:25	13:45	A	7A1-3	乃万 裕一 (昭和電工マテリアルズ)	2.50/30 ICパッケージ-1	Cu結晶の低温度成長と配向制御を利用したCu-SiO <sub>2</sub> ハイブリッド接合の技術	○マリアッパ・ムルゲサン、森 聖晴、菅根 隆理子、佐藤 正浩、小野 光正、植島 寛史	東北大学、 <sup>1</sup> 東北マイクロエレクトロニクス株式会社、 <sup>2</sup> JOU
0021	9月7日	14:00	14:20	A	7A2-1	井上 史大 (横浜国立大学)	2.50/30 ICパッケージ-2	半導体パッケージング工程におけるS/N最適化に関する電圧型大型圧プラズマによる表面改質効果の研究	○ハン・セリョン、ソウ・ジョウウ、有田 潔	西日本工業大学
0053	9月7日	14:20	14:40	A	7A2-2	井上 史大 (横浜国立大学)	2.50/30 ICパッケージ-2	Si/Al同時析出と高純度低炭化で形成したピピッド(Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> )の膜	○渡辺 直也、山本 寧一、三 貴章、山本 寧一	産業技術総合研究所、 <sup>1</sup> 熊本工作機械製作所
0062	9月7日	14:40	15:00	A	7A2-3	西田 秀行 (ニシダエレクトロニクス実装技術支店)	2.50/30 ICパッケージ-3	サンプリングモジュールを用いたアンダーフィル材の内部ひずみ測定	○吉田 拓哉、藤本利幸、阿部早苗、山口博	ナニックス
0044	9月7日	15:15	15:35	A	7A3-1	西田 秀行 (ニシダエレクトロニクス実装技術支店)	2.50/30 ICパッケージ-3	2次元材料を3次元パッケージに導入するためのシミュレーションによる検討	○古江 文乃、松本 聡、長谷川 雅博	九州工業大学、 <sup>1</sup> 産業技術総合研究所
0046	9月7日	15:35	15:55	A	7A3-2	西田 秀行 (ニシダエレクトロニクス実装技術支店)	2.50/30 ICパッケージ-3	人工型骨格モデルの歩行制御を行うハルス形ハードウェアニューラルネットワークによる人工骨格の開発	○石橋 元規、武田 健樹、石塚 俊彦、渡辺 直也、山崎 大樹、藤原 隆、金子 美奈、西藤 隆、内木 文男	日本大学
0067	9月7日	15:55	16:15	A	7A3-3	西田 秀行 (ニシダエレクトロニクス実装技術支店)	2.50/30 ICパッケージ-3	光ナノインプリントを用いた光電コパッケージ用マイクロミラーの作成	○中村 文、鈴木 謙太、東本 晴博、天野 健	産業技術総合研究所
0023	9月7日	16:30	16:50	A	7A4-1	森 三樹 (東芝)	最先端材料-1	熱分解法による高純度Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> 膜の合成と電極形成に向けたインクジェットプロセスの検討	○柏木 行康、宮崎 淳志、杉本 雅明、小山 優	大阪産業技術研究所、 <sup>1</sup> エレファント、 <sup>2</sup> SSテクノ
0025	9月7日	16:50	17:10	A	7A4-2	森 三樹 (東芝)	最先端材料-1	スズ電解液を想定したSn <sup>2+</sup> ノード材の不動態化評価	○土屋 隆一、吉原 佳知雄、柴田 敏司、中村 勝司	千住金属工業、 <sup>1</sup> 宇都宮大学大学院
0013	9月7日	12:45	13:05	B	7B1-1	津波 徹哉 (日本スベリア社)	環境配慮型実装技術エレクトロニクス	ハイスのつきによる銅箔材の析出形態制御と充放電特性	○松本 周、成木 夏輝、岡本 尚樹、齊藤 文晴	大阪公立大学大学院
0069	9月7日	13:05	13:25	B	7B1-2	津波 徹哉 (日本スベリア社)	環境配慮型実装技術エレクトロニクス	表面改質したZnOナノ粒子を添加したSn <sup>2+</sup> 合金の作成と評価	○新田 幸也、 <sup>1</sup> 真崎 真、 <sup>2</sup> 西川 宏	大阪大学大学院、 <sup>1</sup> 大阪大学接合科学研究所
0019	9月7日	13:25	13:45	B	7B1-3	津波 徹哉 (日本スベリア社)	環境配慮型実装技術エレクトロニクス	金ナノ粒子によるセルロースナノファイバの導電化とその電気特性評価	○孫 裕盛、坂田 広志、山本 謙二、定条 謙次、松本 隆	大阪公立大学大学院
0035	9月7日	14:00	14:20	B	7B2-1	石井 利昭 (日立Astemo)	最先端材料-1	ストレッチャブル印刷配線の立体成形過程における伸長歩長を利用した配線抵抗の低減	○大崎 隆博、井上 賢博	群馬大学大学院理工学府
0051	9月7日	14:20	14:40	B	7B2-2	石井 利昭 (日立Astemo)	最先端材料-1	交流インピーダンス法による導電性接着剤のキュア過程における導電コネクタ発達挙動解析	○井上 賢博	群馬大学大学院理工学府
0058	9月7日	14:40	15:00	B	7B2-3	石井 利昭 (日立Astemo)	最先端材料-1	膜状シリコンを用いた高放熱低熱膨張基板の開発	○伊藤 洋平、高西 謙二、坂本 竜也、藤原 智規、新井 等	三菱電機
0001	9月7日	15:15	15:35	B	7B3-1	津谷 義樹 (村田製作所)	最先端材料-2	膜状シリコンを用いた高放熱低熱膨張基板の開発	○石松 由香里、小田 大輔、井上 賢博	群馬大学大学院
0052	9月7日	15:35	15:55	B	7B3-2	津谷 義樹 (村田製作所)	最先端材料-2	銅系導電性ペーストの電気伝導特性および信頼性に対する界面化学的効果	○高橋 真典、井上 賢博	群馬大学大学院
0057	9月7日	15:55	16:15	B	7B3-3	津谷 義樹 (村田製作所)	最先端材料-2	銅系導電性ペースト/電極間の界面層および界面電気伝導性におけるバインディングの影響	○高橋 真典、井上 賢博	群馬大学大学院
0005	9月7日	16:30	16:50	B	7B4-1	井上 雅博 (群馬大学)	最先端材料-3	銅モリブデン複合材料を用いた高放熱低熱膨張基板の開発	○高橋 真典、井上 賢一、村中 義和、丸尾 知哉、藤原 隆、安藤 拓哉、石川 智紀	サンエレクトロニクス
0060	9月7日	16:50	17:10	B	7B4-2	井上 雅博 (群馬大学)	最先端材料-3	反応性スパッタリングによるMAX化合物薄膜形成と実用効果	○若松 和伸、上田 和寛、岡本 尚樹、齊藤 文晴	大阪公立大学大学院
0071	9月7日	17:10	17:30	B	7B4-3	井上 雅博 (群馬大学)	最先端材料-3	真空印刷技術を用いた微小穴へのペースト充填について	○内田 一成、古川 謙人、小野寺 浩、神保 至	シーマ電子
0054	9月7日	12:45	13:05	C	7C1-1	松本行康 (大阪産業技術研究所)	プリンタブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス	超柔軟生体電位センサー創出に向けたストレッチャブル配線膜の開発	○川崎 博、青木 雅平、秋山 雅博、岡田 拓哉、古賀 大樹、植村 隆夫、能木 隆、菅沼 克明、野宮 健	大阪大学、 <sup>1</sup> セメダイン
0063	9月7日	13:05	13:25	C	7C1-2	松本行康 (大阪産業技術研究所)	プリンタブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス	弾力性を備えたニットセンサーによるウェアラブルウェアの研究	○奥 小波、堀 典子、鶴岡 利至、牛島 洋史	産業技術総合研究所
0022	9月7日	13:25	13:45	C	7C1-3	松本行康 (大阪産業技術研究所)	プリンタブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス	無人自動運転サービスの実用化に向けた各種気象環境技術の開発	○藤原 浩樹、廣 浩之、田中 浩和	エスベック
0029	9月7日	14:00	14:20	C	7C2-1	池田 徹 (鹿児島大学)	信頼性技術-1	線形ラマン分光法による多層電極付n形4H-SiC結晶の動的応答特性に関する研究	○近藤 聖也、須田 周	中京大学大学院
0030	9月7日	14:20	14:40	C	7C2-2	池田 徹 (鹿児島大学)	信頼性技術-1	高電圧電流下におけるグラフェン/シリコン・フレキシブル電子配線の損傷	○大坪 拓生、登川 和家、藤崎 和弘、三浦 誠太郎	弘前大学
0038	9月7日	14:40	15:00	C	7C2-3	池田 徹 (鹿児島大学)	信頼性技術-1	シリコン/シリコン接合と接合信頼性向上のための構造設計	○藤原 浩樹、藤原 聖志、上島 悠、菅沼 克明	大阪大学産業科学研究所、 <sup>1</sup> 株式会社ダイセル
0070	9月7日	15:15	15:35	C	7C3-1	池田 徹 (鹿児島大学)	信頼性技術-2	Bonding reliability of encapsulation epoxy and substrate for power module under high temperature and	○Shuaijie Zhao <sup>1</sup> , Chuanrong Chen <sup>1</sup> , Minoru Ueshima <sup>2</sup> , Motoharu Hagi <sup>3</sup> , Katsuki Saganuma <sup>3</sup>	<sup>1</sup> SANKEN, Osaka University, <sup>2</sup> Daiichi Corporation
0072	9月7日	15:35	15:55	C	7C3-2	池田 徹 (鹿児島大学)	信頼性技術-2	SiC-MOSFETのポリアイソダイオードを利用した高速パワースイッチング	○安藤 文樹、安藤 拓司、佐藤 弘	産業技術総合研究所
0056	9月7日	15:55	16:15	C	7C3-3	池田 徹 (鹿児島大学)	信頼性技術-2	半導体パッケージ高配線用絶縁膜層とシリコンウェハ上の銅膜界面の剥離劣化促進機構	○藤 篤文、高谷 義治	芝浦工業大学大学院、 <sup>1</sup> 芝浦工業大学
0006	9月7日	16:30	16:50	C	7C4-1	山中 公博 (中京大学)	信頼性技術-3	高電圧配線スタックコア部界面の層間剥離はく離動力に由来する剥離解析	○野崎 剛、高谷 義治、 <sup>1</sup> 広島 貴之、 <sup>2</sup> 武富 信雄、 <sup>3</sup> 大橋 健一、 <sup>4</sup> 宮岡 健一、 <sup>5</sup> 坂井 和志、 <sup>6</sup> 葉山 慎一、 <sup>7</sup> Jack Tan	芝浦工業大学、 <sup>1</sup> NTIエレクトロニクスクロステクノロジー、 <sup>2</sup> 昭和電工マテリアルズ、 <sup>3</sup> HEP User Group
0004	9月7日	17:10	17:30	C	7C4-3	山中 公博 (中京大学)	信頼性技術-3	Sn酸化膜に基づくんだ付け試験の新規前処理の検討	○泉 大輔、長野 秀幸	TDK
	9月7日	13:05	13:45	D	7D1-2	森裕幸 (日本アイ・ピー・エム)	依頼講演-1	検討中	○菅沼 克明	大阪大学
0010	9月7日	14:00	14:20	D	7D2-1	小原 さゆり (日本アイ・ピー・エム)	記録板・インターポーザ	新規な熱硬化型低Df/DIフィルムとその応用特性	○高 明夫、 <sup>1</sup> 米田 一徳、 <sup>2</sup> 神田 和貴、 <sup>3</sup> 青山 良朗、 <sup>4</sup> 石川 信広、 <sup>5</sup> 関口 玲也、 <sup>6</sup> 三島 翔子	太陽インキ製造、 <sup>1</sup> 太陽ホールディングス
0059	9月7日	14:20	14:40	D	7D2-2	小原 さゆり (日本アイ・ピー・エム)	記録板・インターポーザ	UV硬化型エポキシ樹脂を用いた基板平滑表面への微細配線形成	○西田 昌典、 <sup>1</sup> 乃乃 裕一、 <sup>2</sup> 岩谷 智樹、 <sup>3</sup> 山口 真樹、 <sup>4</sup> 齋藤 一将	昭和電工マテリアルズ
0003	9月7日	14:40	15:00	D	7D2-3	小原 さゆり (日本アイ・ピー・エム)	記録板・インターポーザ	高速リジッド基板における銅シード銅配線	○田村 礼、 <sup>1</sup> 深澤 正志、 <sup>2</sup> 富士川 匡	DIC
	9月7日	15:15	15:55	D	7D3-1	森裕幸 (日本アイ・ピー・エム)	依頼講演-2	高密度実装製品に向けたプラズマ応用技術	○藤原 大輔	アルバック
0065	9月7日	15:55	16:15	D	7D3-3	河野 好映 (オムロン)	ものづくりセッション	インクジェット法を用いた酸化銅電極の形成	○宮崎 淳志、杉本 雅明	エレファント
0002	9月7日	16:30	16:50	D	7D4-1	河野 好映 (オムロン)	ものづくりセッション	低周波・短時間硬化接着剤	○徳平 英士、 <sup>1</sup> 八木 宏久、 <sup>2</sup> 伊達 仁昭	日産産業
0012	9月7日	16:50	17:10	D	7D4-2	河野 好映 (オムロン)	ものづくりセッション	セミアナログプロセスにおける微細配線対応シード層エッチング	○文蔵 隆志、 <sup>1</sup> 樋口 拓太	JOU
0039	9月7日	17:10	17:30	D	7D4-3	河野 好映 (オムロン)	ものづくりセッション	反りを防止する低膨張率銅めっきの膜特性向上	○近藤 和夫、 <sup>1</sup> トランパン ナハト アン	微小めっき研究所